

2019年 関西表面技術シンポジウム

ウェットプロセスを基盤とした材料開発ならびに解析技法の展開
電気鍍金研究会
表面技術協会関西支部
表面技術協会ウェットプロセス研究部会

電気鍍金研究会の「次世代めっき技術連携開発プロジェクト第4期」の最終報告と表面技術協会関西支部の特別講演会を兼ねて表記のシンポジウムを開催いたします。

多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

日時： 2019年7月31日(水) 13:30～16:30

会場： 大阪鍍金会館 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14)

JR環状線 玉造駅 下車徒歩5分

参加費： 会員 3,000円、学生 1,000円、非会員 6,000円 (いずれもテキスト代含む)

申込方法：参加希望者は、申込み書に必要事項をご記入の上、7月5日(金)までにファックスでお申し込みください。なお、参加費は当日徴収いたします。

申込先： 電気鍍金研究会事務局 (〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14 大阪鍍金会館内)

TEL/FAX 06-4259-6890

定員： 90名 (先着順)

プログラム

13:30-14:20 講演：「超高感度加速度センサ実現のための高強度金合金材料の創成とその機械的特性評価」

(東京工業大学) 曾根正人

SiベースのMEMS加速度センサの構成材料を、金あるいは金合金に変えることにより超高感度化を達成できることが報告されている。しかし金は一般に柔らかい金属であり、高強度化が課題である。本講演では、めっき反応制御により、シリコンに匹敵する金属材料の高強度化を実現すると同時に、その機械的強度評価について報告する。

14:20-14:30 休憩：

14:30-15:20 講演：「超濃厚電解質水溶液を用いる電析3題」

(京都大学) 邑瀬邦明

電解質(イオン)と相互作用していないフリーな水分子(自由水)が少ない超濃厚な電解質水溶液を、電気化学プロセスへ応用する研究が増えつつある。本講演では、演者の研究室において取り組んでいる3つの電析事例を紹介し、超濃厚水溶液とそこから電析挙動にみられる特異性を考察する。

15:20-15:40 休憩：

15:40-16:30 ポスタープレゼンテーション(各2分間のショートプレゼンテーションを含む)：

1. 低水素脆性亜鉛系めっきの開発(Ⅱ)

(広島工業大学) 日野 実

2. めっきにおける水素共析と水素誘起現象の解析

(兵庫県立大学) 八重真治・福室直樹

3. 無電解めっき法によるインバー合金薄膜の開発

(京都市産業技術研究所) 山本貴代

4. 非晶質Cr-C合金めっきの平滑化および厚膜化

(大阪技術研・和泉センター) 林 彰平

5. 水溶液からの遷移金属硫化物電析とリチウム二次電池への応用

(大阪技術研・森之宮センター) 池田慎吾

6. 水溶液電析法によるジルコニア構造体膜の作製

(大阪技術研・森之宮センター) 千金正也

7. ウェットプロセスによる機能性磁性薄膜の作製

(奈良工業高等専門学校) 藤田直幸

※ポスタープレゼンテーションは、発表時間中に発表者と聴講者が自由に質疑応答できます。

「次世代めっき技術連携開発プロジェクト」の企業と研究者のマッチングのために活用ください。

F A X 送 信 票

2019年 月 日

電気鍍金研究会 事務局 御中

F A X : 0 6 - 4 2 5 9 - 6 8 9 0

2019年関西表面技術シンポジウム

ウェットプロセスを基盤とした材料開発ならびに解析技術の展開

参 加 申 込

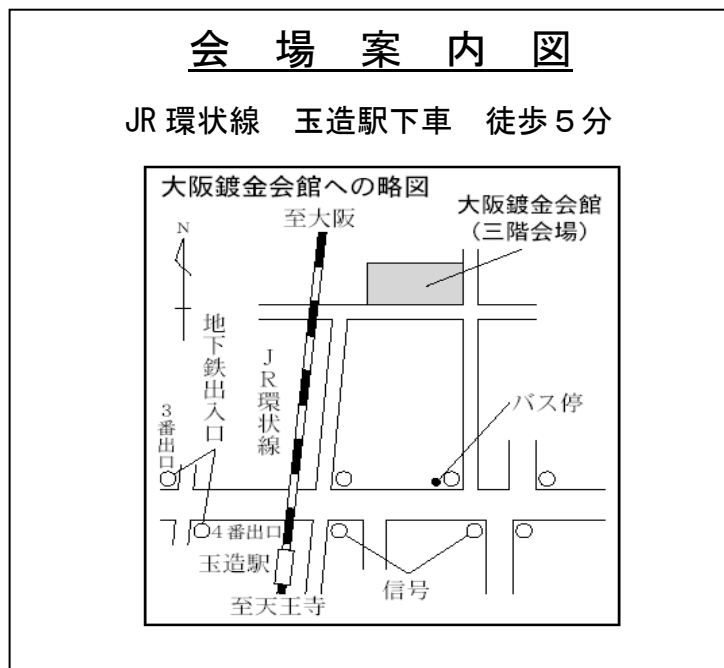
氏名 _____

社名/所属 _____ 部署 _____

TEL _____ FAX _____

会員資格 (該当するものを全てチェックして下さい)

- 電気鍍金研究会 表面技術協会 学生 会員外



申込先：電気鍍金研究会事務局 TEL/FAX 06-4259-6890

大阪市東成区中道 3-1-14 大阪鍍金会館内